

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2026-008

兆易创新科技集团股份有限公司

关于使用 A 股部分募集资金向全资子公司及全资孙公司

增资以实施 DRAM 募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）于 2026 年 1 月 22 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用 A 股部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资以实施 DRAM 募投项目的议案》，同意公司使用 A 股募集资金 50,000 万元向全资子公司珠海横琴芯存半导体有限公司（以下简称“珠海芯存”）增资，并由珠海芯存使用 A 股募集资金向全资孙公司合肥芯存半导体有限公司（以下简称“合肥芯存”）、全资孙公司西安芯存半导体有限公司（以下简称“西安芯存”）分别增资 3,000 万元、5,000 万元，以实施 DRAM 募投项目。该事项无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]711 号核准），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股）21,219,077 股，发行价格为人民币 203.78 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 432,402.35 万元，扣除承销费用（不含增值税）人民币 3,958.49 万元后，公司此次实际募集资金净额为人民币 428,443.86 万元。上述募集资金已由保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于 2020 年 5 月 26 日分别汇入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行开设的 32310188000045744 账户及在招商银行北京分行清华园支行开设的 110902562710703 账户中。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字[2020]第 010036

号”验资报告。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司（含作为募投项目实施主体的全资子公司、全资孙公司，下同）开设了募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构以及存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

本次募集资金扣除发行费用后原计划用于“DRAM 芯片研发及产业化项目”和补充流动资金。经公司于 2024 年 11 月 26 日召开的 2024 年第四次临时股东会审议通过，公司调整前述“DRAM 芯片研发及产业化项目”的用途及规模，并新增募投项目“汽车电子芯片研发及产业化项目”和补充流动资金。调整后的募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	调整后募集资金承诺投资总额（万元）
1	DRAM 芯片研发及产业化项目	282,413.75
2	汽车电子芯片研发及产业化项目	70,644.12
3	补充流动资金 1	96,041.51
4	补充流动资金 2	20,539.92
合计		469,639.30

注：“调整后募集资金承诺投资总额”与“实际募集资金净额”的差额为募集资金利息收入再投入。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况请详见 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《兆易创新 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-045）。

三、本次使用 A 股部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的情况

（一）本次增资对象的基本情况

1. 珠海芯存

公司名称：珠海横琴芯存半导体有限公司

统一社会信用代码：91440003MADRAPUU4K

企业类型：有限责任公司

住所：珠海市横琴港澳大道 868 号市民服务中心 2 号楼政务服务中心 114 室-1438
(集中办公区)

法定代表人：马思博

注册资本：人民币 10,000 万元

成立日期：2024 年 07 月 11 日

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月
总资产	128,963.44	156,194.71
净资产	88,712.23	92,422.46
营业收入	3,873.23	41,314.07
净利润	-1,559.06	2,593.72

注：2025 年 1-9 月财务数据未经审计。

2. 合肥芯存

公司名称：合肥芯存半导体有限公司

统一社会信用代码：91340111MA8PXWTY45

企业类型：有限责任公司

住所：安徽省合肥市经济技术开发区清华路 368 号合肥格易集成电有限公司辅楼 5 层 01 室

法定代表人：何卫

注册资本：人民币 3,000 万元

成立日期：2023 年 01 月 30 日

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月
总资产	2,547.63	3,250.14
净资产	1,781.12	1,143.34
营业收入	0	29.46
净利润	-243.10	-706.72

注：2025 年 1-9 月财务数据未经审计。

3. 西安芯存

公司名称：西安芯存半导体有限公司

统一社会信用代码：91610131MAC4PP7Q4Y

企业类型：有限责任公司

住所：西安市高新区天谷八路 211 号西安环普科技产业园 G1 幢 13 层 1302 室

法定代表人：何卫

注册资本：人民币 6,000 万元

成立日期：2022 年 12 月 08 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月
总资产	6,174.87	8,878.63
净资产	4,791.38	3,432.98
营业收入	0	33.61
净利润	-191.59	-1,463.47

注：2025 年 1-9 月财务数据未经审计。

（二）本次增资方案

公司拟以“DRAM 芯片研发及产业化项目”专户的 A 股募集资金向项目实施主体珠海芯存增资 50,000 万元，并由珠海芯存使用募集资金向合肥芯存、西安芯存分

别增资 3,000 万元、5,000 万元，以实施该募投项目，详细情况如下：

单位：万元人民币

提供增资方	被增资方	增资金额	其中：计入注册资本	其中：计入资本公积
公司	珠海芯存	50,000.00	5,000.00	45,000.00
珠海芯存	合肥芯存	3,000.00	1,000.00	2,000.00
珠海芯存	西安芯存	5,000.00	1,000.00	4,000.00

本次增资完成后，珠海芯存注册资本由 10,000 万元变更为 15,000 万元，仍为公司全资子公司；合肥芯存和西安芯存注册资本分别由 3,000 万元、6,000 万元变更为 4,000 万元、7,000 万元，仍为公司全资孙公司。

（三）本次增资后的募集资金管理

本次增资的资金将存放于公司已开立的募集资金专用账户，公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定规范存放、管理和使用募集资金。

四、本次增资对公司的影响

公司本次使用 A 股部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资，是基于公司 DRAM 募投项目的建设需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、本次增资履行的审议程序

公司于 2026 年 1 月 22 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用 A 股部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资以实施 DRAM 募投项目的议案》，保荐机构出具了明确同意的核查意见。本次增资不属于变更募集资金用途，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：兆易创新本次使用 A 股部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。兆易创新本次使用 A 股部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的事项系基于公司实际经营发展需要，不会对募投项目实施造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用 A 股部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的事项无异议。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日